



FM5821_V8 制板说明:

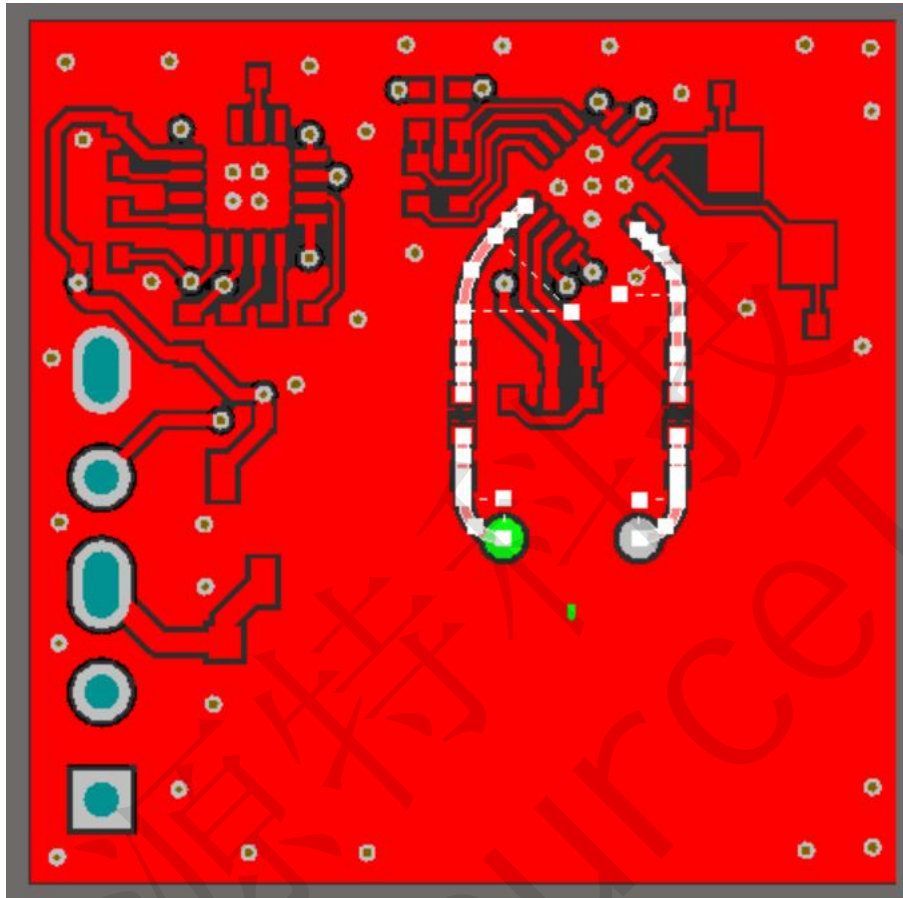
| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|--|
| 技术联系人: | 0755-27595155 | 传真 | |
| 邮件地址: | Info@ChipSourceTek.com | 交期 | |
| 板名: | | | |
| 层数 | 4 | 第三层为空层 | |
| 数量 | | | |
| 板材类型 | FR-4 | 可混压 | |
| 完成板厚及公差 (mm) | 1.6+/-0.1mm (备注) | | |
| 铜箔要求 (基铜) | 0.035/0.0152/0.0152/0.035mm | | |
| 完成铜厚 | 0.035/0.0152/0.0152/0.035mm | 满足阻抗 可调 | |
| 单元尺寸 (mm) | 按照文件尺寸 | | |
| 每个拼板中的单元数量 | | | |
| 阻焊 | YES | 绿色/高温阻焊油 | |
| 可剥离阻焊 | NO | | |
| 碳油 | NO | | |
| 字符 | YES | 白色 | |
| 阻焊覆盖 | 过孔盖油 | | |
| 表面处理 | 表面无铅喷锡 | | |
| 过孔要求 | | | |
| 文件格式及版本 | | | |
| 外形 | 铣 | | |
| 标记 | | | |
| 叠层顺序 | 按文件 (备注) | | |
| 验收标准 | IPCII | | |
| 其他 | ROHS | | |

备注:

1. 第一层为 TOP, 第二层为 GND, 第三层为**空层**, 第四层为 Bottom。
2. 要求使用 **FR-4** 板材, **FR-4** 介电常数 4.6 +/-0.1。阻焊 介电常数 3.8 走线面上阻焊 0.5mil, 基材上阻焊 0.8mil
3. 要求控制射频线路阻抗 (线宽 0.238mm, 到地间距 0.127mm 已设定, 可更改, 阻抗计算约为 50 欧姆)
4. 要求 top 层表面完成铜箔厚度为 **0.035mm**; 出货报告须注明阻抗控制线的线宽, 到地间距, 以及切片表面铜箔厚度和每层介质厚度。



要求 50 欧姆阻抗控制的白色线路如下图：



成品板厚：1.6MM(参考)

| 层名 | 材料 | 厚度 (mil) | 厚度 (mm) |
|----|-------------------|----------|---------|
| L1 | 外层铜厚1oz | 1.38 | 0.0350 |
| PP | 7628 RC49% 8.6mil | 8.28 | 0.2104 |
| L2 | 内层铜厚 | 0.60 | 0.0152 |
| 芯板 | 1.1mm H/HOZ 含铜 | 41.93 | 1.0650 |
| L3 | 内层铜厚 | 0.60 | 0.0152 |
| PP | 7628 RC49% 8.6mil | 8.28 | 0.2104 |
| L4 | 外层铜厚1oz | 1.38 | 0.0350 |